

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

78期事業のご報告

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社長メッセージ



拡大し続ける半導体需要が「高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術」の拡大につながり、売上高・利益は過去最高を更新しました。

事業環境・業績

2016年度は、スマートフォンに加えてデータセンタ向けに高性能な半導体の需要が高まったことから、フラッシュメモリを中心に積極的な設備投資が見られました。また、半導体以外の分野においても精密加工のニーズが高まっており、部品メーカーなどへの装置出荷も増加傾向にありました。

こうした加工ニーズの高まりは消耗品である精密加工ツールの売上にも表れており、年々着実な増加を続けております。

その結果、前年度から為替の影響は受けたものの、売上高は4期連続、営業利益は3期連続で過去最高を更新しました。

株主還元につきましては、配当方針に基づ

き、業績連動型の配当に加え、余剰資金からの追加配当※を上乗せして1株当たりの配当金は年間374円とさせていただきます。

今後の見通し

2017年度は、引き続きデータセンタやスマートフォン、自動車向けなど様々な最終製品において、より一層高性能な半導体需要が高まっていることから、メモリを中心に幅広いアプリケーションで「高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術」が拡大すると思われます。増え続けるお客さまの加工ニーズへ対応するため、桑畑工場の拡張や積極的な研究開発を進めております。

しかし変化の激しい半導体業界においては先々を予測することは困難なため、会社は事業

環境の変化に素早く対応する力が求められます。中長期視点で会社を強くするためにも、良質な企業文化の醸成に注力するとともに、社員一人ひとりが能動的に動ける仕組みづくりや進化・改善活動を継続してまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※追加配当について
年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額を超過した場合は、業績連動分に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せいたします。

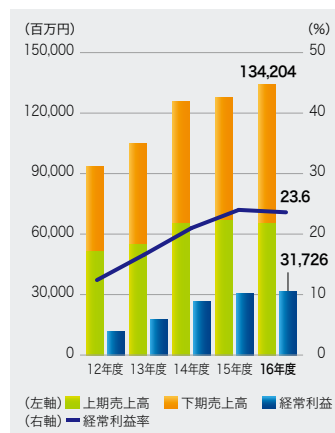
2017年6月

代表取締役社長 関家一馬

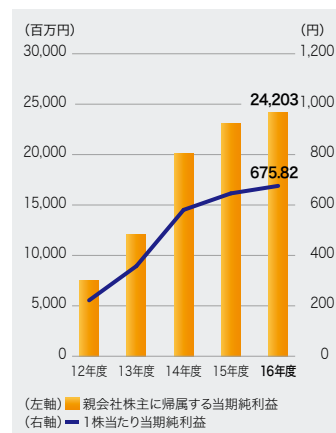


財務ハイライト

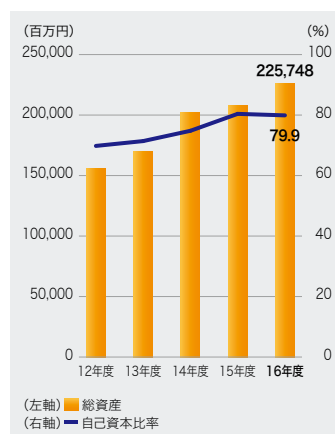
売上高・経常利益・経常利益率



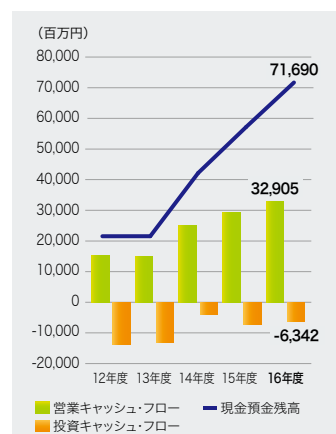
親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)においては、データセンタ向けサーバやスマートフォンの高機能化に伴い、メモリ向けを中心に半導体メーカ各社は設備投資を積極的に行いました。精密切断装置(ダイサ)・精密研削装置(グラインダ)ともにメモリ向けが堅調に推移した一方、前期好調だった電子部品向けや光半導体向けが減少したことにより、精密加工装置の売上高は約4%減少しました。消耗品である精密加工ツールは、メモリの薄化需要の高まりと顧客の高い設備稼働率に比例して、グラインディングホイールを中心に出荷数量が大幅に増加しました。その結果、精密加工ツールの売上高は過去最高となりました。これらの結果、為替による売上高の減少影響があったものの、連結売上高は4期連続で過去最高を更新しました。

利益については、為替による粗利益の減少、研究開発費・人件費などの販売管理費の増加があったものの、売上高の増加および製品構成の良化等により、営業利益は微増となりました。

以上の結果、当期の業績は売上高1,342億4百万円(前期比5.0%増)、営業利益313億41百万円(同3.3%増)、経常利益317億26百万円(同3.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益242億3百万円(同4.8%増)となり、各利益とも過去最高を更新しました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ177億94百万円増加し、2,257億48百万円となりました。これは主に現預金や売掛金が増加したことによるものです。

負債は、前期末と比べ45億12百万円増加し、444億

30百万円となりました。これは仕入債務が増加したことによるものです。純資産は、前期末と比べ132億82百万円増加し、1,813億18百万円となり、自己資本比率は前期末比0.5ポイント低下し79.9%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では、329億5百万円の資金増加、投資活動では、63億42百万円資金減少だったことからフリー・キャッシュ・フローは、265億63百万円の資金増加となりました。これは、投資活動において桑畑工場の拡張などによる資金支出があったものの、営業活動において税金等調整前当期純利益や減価償却費などで大幅な資金増加があったためです。財務活動では、主に配当金の支払によって119億56百万円の資金減少となりました。これらの結果、当期末の資金残高は前期末から145億28百万円増加し、716億90百万円となりました。

上半期の連結業績予想

半導体や電子部品などで高度なKiru・Kezuru・Migaku技術の需要が拡大しており、精密加工装置や精密加工ツールともに高水準の出荷が見込まれることから、半期では過去最高の売上高・営業利益を見込んでおります。中間期の配当については、1株当たり109円を見込んでおります。

2018年3月期上半期

(金額の単位:百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
80,100	21,300	21,600	15,500	432.16円



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができていくか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。